

2022年11月16日

トピー工業株式会社

ディープリンング×ハードウェア
高専生による事業創出コンテスト「DCON2023」を特別協賛

トピー工業株式会社（本社：東京都品川区、社長：高松信彦、以下「トピー工業」）は、このたび一般社団法人日本ディープリンング協会（理事長：松尾豊 東京大学大学院工学系研究科 教授）が主催する「第4回全国高等専門学校ディープリンングコンテスト2023（以下「DCON2023」）」に特別協賛します。DCON2023は、高等専門学校生（以下「高専生」）が日頃培った「ものづくりの技術」と「ディープリンング」を活用した作品を制作し、その作品によって生み出される「事業性」を事業評価額で競うコンテストです。



機械・電気・ディープリンングという新三種の神器がそろった技術者を育てるというDCON2023の主旨に賛同するとともに、ディープリンングとハードウェアの融合から新しい価値を生む製品やサービスを高専生が競い合って創造する点が、トピー工業グループの特色である「素材から製品までの一貫生産」のものづくりの概念に通じると思い、協賛を決定しました。

トピー工業グループは、「鉄をつくり、鉄をこなす」高い技術力と一貫生産体制を軸に、お客様や社会のニーズに応えた製品やサービスを提供することで、グローバル展開の道を切り開き、さらにコア技術を応用して周辺分野にも事業展開し、成長を続けてきました。今後も、これまで培ってきた強みと経営資源を最大限活用し、社会課題の解決に取り組み、社会的価値を創出することで、持続的な成長を実現していきます。

【DCON2023 概要】

名称：第4回全国高等専門学校ディープリンングコンテスト2023

本選開催日時：2023年4月28日・29日

URL：<https://dcon.ai/>

【お問い合わせ先】総務部 広報・IR室 TEL 03-3493-0777